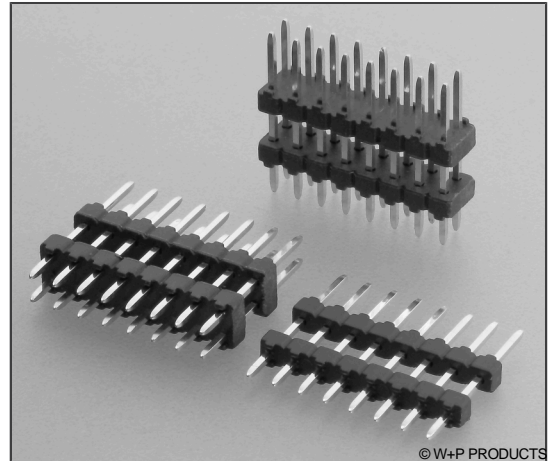


# 149 / 150 / 151

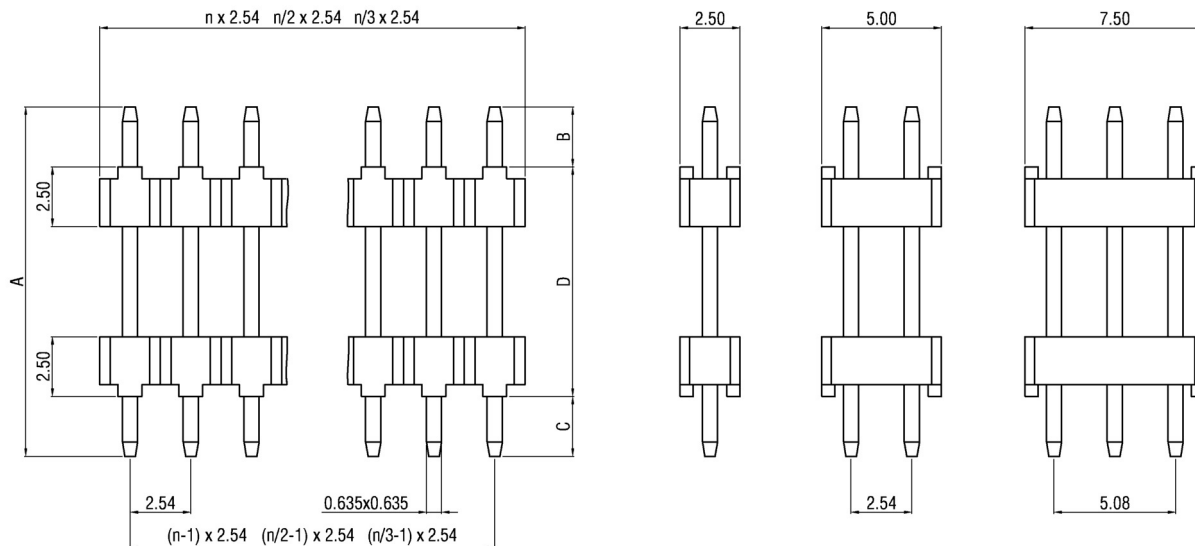
## Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, 1-/2-/3-reihig Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, 1/2/3 Rows

### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV DC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



Passende Buchsenleisten:  
*Compatible Female Headers:*  
**153 154 340 348 624** etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
*Please see ch. B for more*



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12  
*Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.*

# 149 / 150 / 151

Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, 1-/2-/3-reihig  
Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, 1/2/3 Rows

## Series\*

**150**

Thermisch gerissene Kontakte  
*Electro-strictioned contacts*  
**149** Einreihig  
*Single row*  
**150** Zweireihig  
*Double row*  
**151** Dreireihig  
*Triple row*

## Dimensions\*

**19**

**16** A=17,70 B=5,70 C=3,30 D=8,70mm  
**17** A=19,80 B=5,70 C=3,30 D=10,80mm  
**18** A=21,60 B=5,70 C=3,30 D=12,60mm  
**19** A=22,80 B=5,70 C=3,30 D=13,80mm  
**20** A=24,90 B=5,70 C=3,30 D=15,90mm  
**21** A=26,70 B=5,70 C=3,30 D=17,70mm  
**22** A=29,00 B=5,70 C=3,30 D=20,00mm  
**23** A=30,80 B=5,70 C=3,30 D=21,80mm  
**24** A=37,80 B=5,70 C=3,30 D=28,80mm  
**25** A=40,80 B=5,70 C=3,30 D=31,80mm  
**26** A=45,30 B=5,70 C=3,30 D=36,30mm  
**A/B/C** Gesamtlänge & Wunschmaße  
*Total length & Dimensions*

## Contacts\*

**010**

**001-050** Einreihig  
*Single row*  
**004-100** Zweireihig  
*Double row*  
**006-120** Dreireihig  
*Triple row*

## Plating\*

**00**

**00** Au flash  
**10** Au 0,25µm  
**30** Au 0,75µm  
**50** Sn  
Au flash min. 0,1µm  
*Au flash min. 0,1µm*  
Weitere Veredelungen auf Anfrage  
*More plating options on request*

B, C, D nach Kundenwunsch variierbar. Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster sowie weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage. Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter Techn. Informationen.

*B, C, D variable acc. to customers' specifications. We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches as well as more dimensions on request. Order page "Customer-specific Pin Configurations" in Technical Information.*

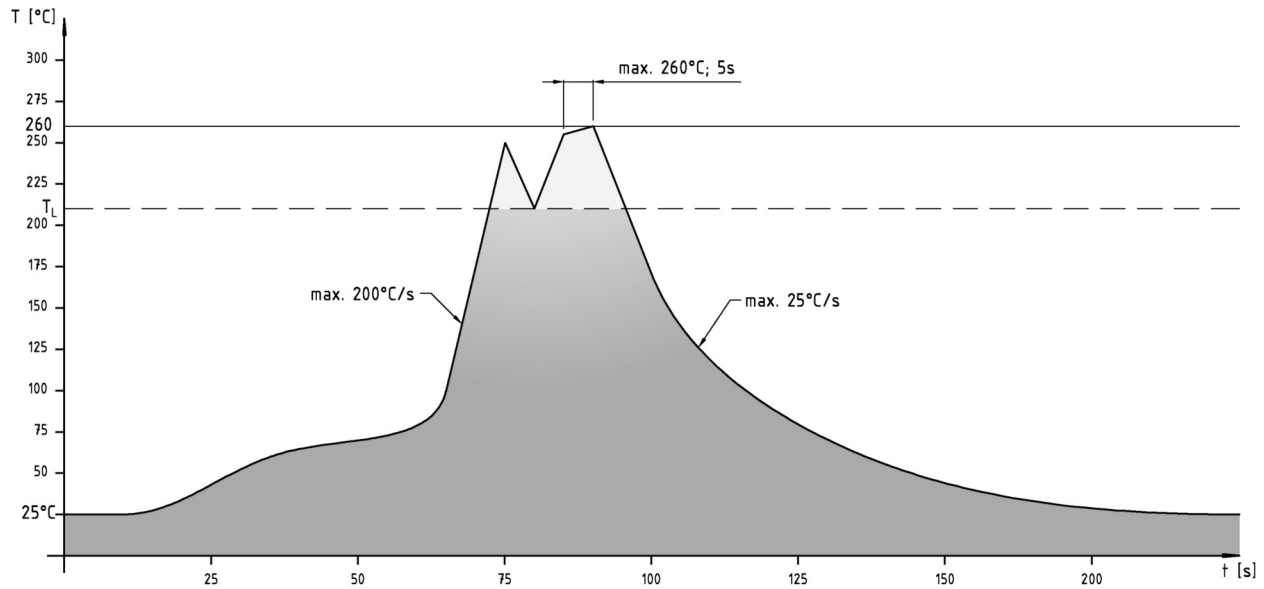
\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* *This is an order example* -  
please replace by your specifications.

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

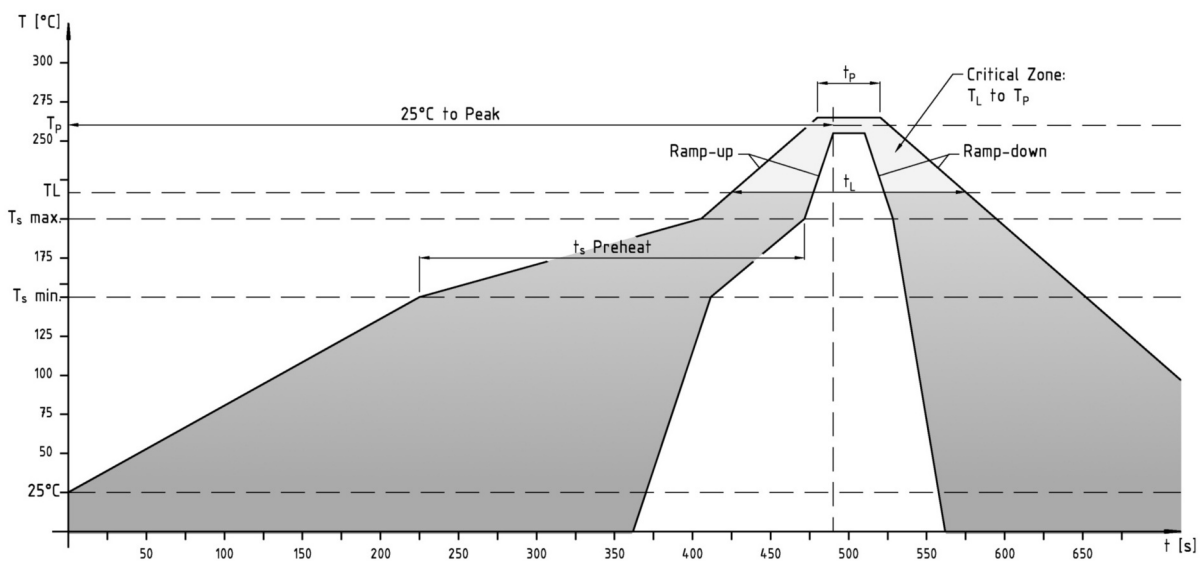
Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

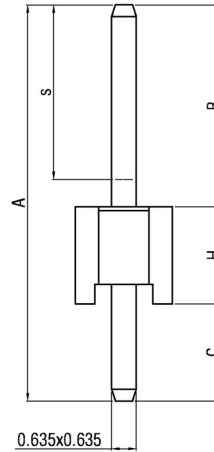
Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min



## Gerade Stiftheiten / Straight Pin Headers

- A : Gesamtstiftlänge / Overall Pin Length
- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

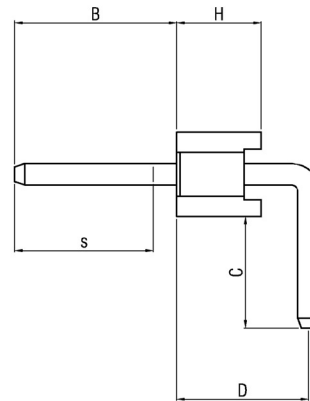
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



## Gewinkelte Stiftheiten / Right-Angled Pin Headers

- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



## PCB Layouts

